

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他（ ）
参与单位名称	2025 年 5 月 22 日 高毅资产、康盛基金、润晖投资、Arrowpoint Investment、Fidelity Investment、UBS Asset Management 等
时间	2025 年 5 月 22 日
调研方式	线下会议
公司接待人员姓名	公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民）
投资者关系活动主要内容介绍	
公司介绍	芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。 公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processing IP）这六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。

	基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AIPC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。 为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。 基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。 芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm/6nm/5nmFinFET 和 28nm/22nmFD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验。此外，根据 IPnest 在 2024 年 5 月的统计，2023 年，芯原半导体 IP 授权业务市场占有率位列中国第一，全球第八；2023 年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据 IPnest 的 IP 分类和各企业公开信息，芯原 IP 种类在全球排名前十的 IP 企业中排名前二。 2024 年上半年，半导体产业逐步复苏，得益于公司独特的商业模式，即原则上无产品库存的风险，无应用领域的边界，公司自二季度起，经营情况快速扭转。公司 2024 年第二季度营业收入规模同比恢复到受行业周期影响前水平，2024 年第三季度营业收入创历年第三季度收入新高，同比增长 23.60%，第四季度收入同比增长超 17%，全年实现营业收入 23.22 亿元，基本与 2023 年持平。截至 2024 年末，公司订单情况良好，在手订单 24.06 亿元，较三季度末的 21.38 亿元进一步提升近 13%，在手订单已
--	---

	连续五季度保持高位。从新签订单角度，2024 年第四季度公司新签订单超 10.8 亿元，2024 年下半年新签订单总额较 2024 年上半年提升超 50%，较 2023 年下半年同比提升超 48%，较半导体行业周期下行及去库存影响下的 2023 年上半年大幅提升超 80%，对公司未来的业务拓展及业绩转化奠定坚实基础。
交流问答	问题：请问公司在 AI/AR 眼镜上有哪些布局？ 回复：在边缘人工智能终端产品中，以 AI/AR 眼镜为代表的智慧可穿戴设备被认为是继智能手机之后的下一个十亿级出货量的产品，这类设备可搭载更为自然的人机交互界面和越来越强大的本地 AI 处理能力，创新人们的数字生活和社交。芯原拥有面向相关领域的极低功耗高性能芯片设计平台，可以打造适应不同功率模式的产品，满足超轻量实时在线、低功耗以及全性能的全场景应用。目前，芯原正在着力 AI/AR 眼镜的技术平台优化和产业化，除了已为某知名国际互联网企业提供 AR 眼镜的芯片一站式定制服务之外，还有数家全球领先的 AI/AR/VR 眼镜客户正在与芯原进行合作。 问题：公司来自哪些下游应用领域的收入增速较快？ 回复：公司不断开拓增量市场和具有发展潜力的新兴市场，受下游市场需求带动，在 2024，受 AI 算力等市场需求带动，公司数据处理领域、计算机及周边领域、汽车电子领域分别实现收入 5.52 亿元、3.24 亿元、2.15 亿元，同比分别上涨 75.46%、64.07%、37.32%，上述领域收入占营业收入比重分别为 23.78%、13.95%、9.27%，收入占比同比分别提升 10.32、5.51、2.56 个百分点。

问题：请问公司 IP 授权收入中特许权使用费收入占比多少，如何看待该业务的增长性？

回复：2024 年，公司特许权使用费收入 1.03 亿元，占整体 IP 授权业务收入约 14%。在公司半导体 IP 授权业务中，公司在向客户交付半导体 IP 时，会收取知识产权授权使用费收入，待客户利用该 IP 完成芯片设计并量产后，公司会根据客户的芯片销售情况，按照量产芯片销售颗数获取特许权使用费收入。长期来看，随着公司半导体 IP 广泛授权，以及客户出货量增长，公司特许权使用费业务收入将呈现增长趋势。

问题：请问公司如何看待 AI 手机的增长趋势以及带来的市场机会？

回复：随着边缘人工智能应用快速发展，公司不断优化升级相关 IP 技术，提升公司自身的竞争力和市场地位。目前，集成了芯原神经网络处理器（NPU）IP 的人工智能（AI）类芯片已在全球范围内出货超过 1 亿颗，主要应用于包含智能手机、平板电脑、可穿戴设备等在内的 10 多个市场领域。为应对手机、电脑对 AI 算力持续增长的需求，公司持续优化和升级公司的 NPU IP，并推出了一系列创新的 AI-ISP、AI-GPU 等基于公司 NPU 技术的 IP 子系统，给传统的处理器技术带来颠覆性的性能提升，为各类终端电子产品提供多维度、高效率的人工智能升级。公司始终关注市场趋势和技术发展动向，积极推进新技术的研发，持续强化研发实力，保持技术先进性及核心竞争力。

问题：请问 Chiplet 技术和公司已有业务的协同情况如何，公司在这个领域的研发布局有哪些？

回复：芯原拥有丰富的处理器 IP，以及领先的芯片设计能力，加上我们与全球主流的封装测试厂商、芯片制造厂商都建立了长久的合作关系，近几年来一直在致力于 Chiplet 技术和产业的推进，通过“IP 芯片化，

	IP as a Chiplet”和“芯片平台化，Chiplet as a Platform”，来促进 Chiplet 的产业化。Chiplet 技术将提高公司的 IP 复用性，增强业务间协同，增加设计服务的附加值，拓宽业务市场空间；进一步降低客户的设计时间、成本和风险，提高芯原的服务质量和效率，更深度绑定客户；并进一步提高公司盈利能力，实现竞争力升维，将芯原的 IP 授权业务和一站式芯片定制服务业务推上新的高度。 目前，公司已在基于 Chiplet 的云侧生成式人工智能和高端智驾两大赛道实现领跑，目前正在推进基于 Chiplet 架构、面向智驾系统和 AIGC 高性能计算的芯片平台研发项目。目前公司在 Chiplet 领域取得的切实成果包括：已帮助客户设计了基于 Chiplet 架构的 Chromebook 芯片，采用了 SiP（System in Package）先进封装技术，将高性能 SoC 和多颗 IPM 内存合封；已帮助客户的 AIGC 芯片设计了 2.5D CoWoS 封装；已设计研发了针对 Die to Die 连接的 UCle 物理层接口，相关测试芯片已流片，即将返回进行封装和测试；已和 Chiplet 芯片解决方案的行业领导者合作，为其提供包括 GPGPU、NPU 和 VPU 在内的多款芯原自有处理器 IP，帮助其部署基于 Chiplet 架构的高性能人工智能芯片，该芯片面向数据中心、高性能计算、汽车等应用领域。此外，为了应对先进封装技术可能出现的供应和成本等问题，芯原已针对新一代面板级封装（Panel level package）技术进行了先行设计开发，为接下来的规模量产做好了准备。本土封装厂也正在积极布局该封装技术，芯原将与之携手，共同打造更具成本效益且供应安全的先进封装解决方案。
--	---